PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-219595

(43) Date of publication of application: 08.08.2000

(51)Int.CI.

C30B 23/00

(21)Application number : 11-020697 (22)Date of filing : 28.01.1999 (71)Applicant : SHIKUSUON:KK

28.01.1999 (72)Invento

(72)Inventor: SHIOMI HIROSHI

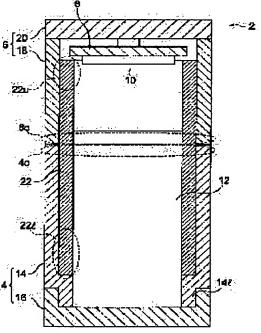
KONDO SHUHEI

(54) CRUCIBLE, CRYSTAL GROWTH DEVICE AND CRYSTAL GROWTH METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a crucible capable of preventing a raw material from leaking to the outside and efficiently growing a single crystal on a seed crystal, and also to provide a device and a method for crystal growth, using the crucible.

SOLUTION: This crucible 2 to be applied to a device for crystal growth is provided with a first outer pipe 4 which has one closed end and is capable of receiving a raw material 12, and a second outer pipe 6 which has one closed end and the open end 60 of which is connected to the open end 40 of the first outer pipe 4 and also which has within it a seed crystal placement section 8 capable of placing a seed crystal 10, and accordingly, capable of growing a crystal on the seed crystal 10 by sublimation of the raw material 12. Further, in the crucible 2, an inner pipe 22 which has a cylindrical shape and the outer peripheral surface of one end 221 of which is in contact with the inner peripheral surface of the



other end 22u of which is in contact with the inner peripheral surface of the second outer pipe 6, is placed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-219595 (P2000-219595A)

(43)公開日 平成12年8月8日(2000.8.8)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考) 4G077

C30B 23/00

C30B 23/00

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-20697

(22)出願日

平成11年1月28日(1999.1.28)

(71)出願人 599012835

株式会社シクスオン

京都府京都市東山区下河原通八坂鳥居前下

ル下河原町463番地の1 グレーシイ京都

東山707号

(72)発明者 塩見 弘

大阪府吹田市原町1-6-19

(72)発明者 近藤 修平

兵庫県姫路市大津区天湖422-8

(74)代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (外4名)

Fターム(参考) 40077 AA02 BE08 DA01 EG25 SA04

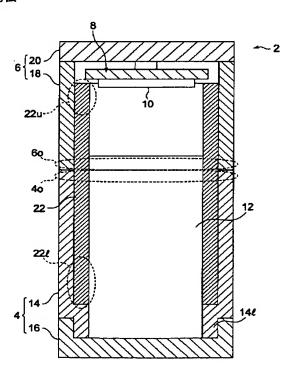
SA11

(54) 【発明の名称】 坩堝、結晶成長装置、および、結晶成長方法

(57)【要約】

【課題】 原料の外部への漏れを防止できるとともに、 種結晶上に単結晶を効率良く成長させることができる坩 堝、結晶成長装置、および結晶成長方法を提供するこ と。

【解決手段】 結晶を成長させる装置に適用され、原料12を収容可能な第一の有底外管4と、第一の有底外管4の開口端40にその開口端60が接続されると共に種結晶10を配置可能な種結晶配置部8を含む第二の有底外管6と、を有し、原料12の昇華に伴って種結晶10上に結晶が成長可能な坩堝2において、筒状形状をなし、一端221の外周面が第一の有底外管4の内周面に接触し、他端22uの外周面が第二の有底外管6の内周面に接触する内管22を更に備えることを特徴とする。



à

【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶を成長させる装置に適用され、原料 を収容可能な第一の有底外管と、前記第一の有底外管の 開口端にその開口端が接続されると共に種結晶を配置可 能な種結晶配置部を含む第二の有底外管と、を有し、前 記原料の昇華に伴って前記種結晶上に前記結晶が成長可 能な坩堝において、

筒状形状をなし、一端の外周面が前記第一の有底外管の 内周面に接触し、他端の外周面が前記第二の有底外管の 内周面に接触する内管を更に備えることを特徴とする坩 10

【請求項2】 前記内管の前記他端は、前記種結晶配置 部の周囲近傍に位置することを特徴とする請求項1記載

【請求項3】 前記内管は、所定の開口孔を有するマス ク部を有し、前記開口孔に臨む位置に、前記種結晶配置 部が位置していることを特徴とする請求項1または請求 項2記載の坩堝。

【請求項4】 前記内管は、黒鉛またはタンタルなどの 高融点材料によって形成されていることを特徴とする請 20 求項1~請求項3のうち何れか一項記載の坩堝。

【請求項5】 前記内管の外周部は黒鉛によって形成さ れ、前記内管の内周部は黒鉛を除くタンタルなどの高融 点材料によって形成されていることを特徴とする請求項 1~請求項3のうち何れか一項記載の坩堝。

【請求項6】 請求項1~請求項5記載のうち何れか一 項に坩堝と、前記坩堝を加熱可能な加熱手段とを少なく とも備えることを特徴とする結晶成長装置。

【請求項7】 請求項6記載の結晶成長装置を準備する 準備工程と、前記加熱手段により前記坩堝を加熱する加 30 熱工程と、を備えることを特徴とする結晶成長方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、昇華法により炭化 ケイ素単結晶などを成長させるために用いられる坩堝、 これを用いた結晶成長装置、および、結晶成長方法に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、昇華法によってSiC単結晶など を成長させるために使用される坩堝として、たとえば特 40 開平2-30699号公報の図1に示されたような、原 料を収容するカップ状の坩堝が使用されていた。そし て、SiC単結晶などの成長を行うに際しては、種結晶 が固定された蓋をこの坩堝の上面に被せることで、内部 の気密を保っていた。

【0003】しかし、このタイプの坩堝によって単結晶 成長を行った場合、生成された単結晶を取り出すには坩 堝を割らなければならず、坩堝の再利用を行うことがで きなかった。この問題を解消し得る坩堝として、たとえ ば特開平8-245299号公報の図9に示されたよう 50 な、原料を収容する下側の有底円筒と種結晶配置部が設 けられた上側の有底円筒とを対向配置させた坩堝があ る。このタイプの坩堝によれば、生成された単結晶を取 り出すには下側の有底円筒と上側の有底円筒とを分離さ せればよいため、坩堝を割る必要がなくなり、坩堝の再 利用を図ることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平8-2 45299号公報に示された下側の有底円筒と上側の有 底円筒とから成るタイプの坩堝には、次のような問題が あった。すなわち、図7に示すように、原料58を収容 する下側の有底円筒52と種結晶60が固定された上側 の有底円筒54とによって坩堝50が形成されているた め、両者の接続部分56に存在する微小な隙間から、昇 華した原料ガスが外部に漏れるという問題があった。

【0005】また、原料58を昇華させて種結晶60上 に効率良く単結晶を成長させるために、原料58を囲う 部分すなわち下側の有底円筒52が最も加熱されるのだ が、このとき、別体であるがゆえに下側の有底円筒52 から上側の有底円筒54への熱伝達が行われにくいとい う問題があった。この結果、上側の有底円筒54の温度 が低くなり、上側の有底円筒54の内周面54aでSi Cなどが再結晶してしまい、原料58の使用効率が低下 して種結晶60上に大型の単結晶を成長させることが困 難であった。

【0006】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたも のであり、原料の外部への漏れを防止できるとともに、 種結晶上に単結晶を効率良く成長させることができる坩 堝、これを用いた結晶成長装置、および、結晶成長方法 を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明に係る坩堝は、結晶を成長させる装置に適用 され、原料を収容可能な第一の有底外管と、第一の有底 外管の開口端にその開口端が接続されると共に種結晶を 配置可能な種結晶配置部を含む第二の有底外管と、を有 し、原料の昇華に伴って種結晶上に結晶が成長可能な坩 堝において、筒状形状をなし、一端の外周面が第一の有 底外管の内周面に接触し、他端の外周面が第二の有底外 管の内周面に接触する内管を更に備えることを特徴とす

【0008】本発明の坩堝によれば、原料を収容する第 一の有底外管から種結晶配置部を有する第二の有底外管 まで延在する内管が備えられているため、第一の有底外 管の開口端と第二の有底外管の開口端との接続部分から 原料が漏れるという事態が防止される。また、原料を昇 華させた際に、第二の有底外管の内周面のうち内管で覆 われている部分では、原料の再結晶は起こらない。さら に、内管の一端は原料に接するため、昇華させられる際 に加熱される原料の熱が内管全体に伝達される。このた

め、内管の温度低下が防止され、当該内管の内周面で原料は再結晶せず、殆どの原料が種結晶上で再結晶することになる。

【0009】また、本発明の坩堝において、内管の他端は、種結晶配置部の周囲近傍に位置することが望ましい。このような構成を採用した場合、第二の有底外管の内周面のうち、当該有底外管の開放端から種結晶配置部が存在する部分までが内管に覆われるため、第二の有底外管の内周面で昇華した原料が再結晶するという事態が一層防止される。

【0010】また、本発明の坩堝において、内管は、所定の開口孔を有するマスク部を有し、開口孔に臨む位置に、種結晶配置部が位置していることが望ましい。このような構成を採用した場合、昇華した原料は、マスク部の開口孔を通過して種結晶配置部に配置される種結晶に到達することができる。このため、種結晶上に単結晶を効率良く成長させることができる。

【0011】さらに、本発明の坩堝において、上記内管の外周部は黒鉛によって形成され、内周部は黒鉛を除くタンタルなどの高融点材料によって形成されていることが望ましい。このような構成を採用した場合、内管を黒鉛のみで形成した場合と異なり、種結晶上で成長する結晶に炭素のインクルージョン等による欠陥が発生する事態を防止できる。また、内管をタンタルのみで形成した場合と比較して、高価なタンタルの使用量が少なくなるためコストを削減できると共に、種結晶上で成長した結晶の熱膨張率とタンタルの熱膨張率との差に起因する熱応力に基づく欠陥が当該結晶に発生する事態を防止することができる。なお、高融点材料には、タンタルのみならず、タンタルカーバイド、ニオブカーバイド、モリブランカーバイドなどの融点が2000℃を超える金属またはその化合物が含まれる。

【0012】本発明に係る結晶成長装置は、上述の坩堝と、当該坩堝を加熱可能な加熱手段とを少なくとも備えることを特徴とする。本発明の結晶成長装置によれば、加熱手段によって坩堝内の原料が昇華されて、種結晶上で単結晶が成長する。この際、坩堝が上述のような構成となっているため、原料の外部への漏れを防止できるとともに、種結晶上で単結晶を効率良く成長させることができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発明に係る坩堝、結晶成長装置、および、結晶成長方法の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、同一要素には同一符号を用いるものとし、重複する記載は省略する。

【0014】[第1実施形態] 図1は、本実施形態の坩堝2を示す断面図である。坩堝2は、主に、SiC多結晶からなる原料12を収容する下側の有底外管(第一の有底外管)4と、SiC単結晶からなる種結晶10がそ 50

の底面に固定された種結晶配置部 8 が設けられている上側の有底外管(第二の有底外管) 6 と、から構成されている。また、有底外管 4 の開口端 4 o と有底外管 6 の開口端 6 o とが接続されて、内部の気密が保たれている。なお、有底外管 4 、有底外管 6 、および種結晶配置部 8 は、黒鉛によって形成されている。また、種結晶 1 0 の直径は、約 4 . 5 c m で、有底外管 4 および有底外管 6 の内径は、約 5 c m である。

【0015】有底外管4は、略円筒状の側管14と、当該側管14の下側の開放端を塞ぐ底部材16とから成る。なお、側管14の下端部141の径は、その上部の径よりも小さくなっており、この下端部141が、底部材16の内壁面と嵌合している。一方、有底外管6は、円筒形状の側管18と、当該側管18の上側の開放端を塞ぐ円板状の蓋部材20とから成る。蓋部材20の底面には、上述の種結晶配置部8が取り付けられている。なお、本実施形態では、有底外管4は側管14と底部材16を接続して、有底外管6は側管18と蓋部材20を接続して構成されているが、必ずしもこのように別体にする必要はなく、有底外管は一体的に形成してもよい。

【0016】また、有底外管4および有底外管6の内部には、本実施形態の特徴である円筒形状の内管22がはめ込まれている。この内管22は黒鉛からなり、下端部221の外周面は有底外管4の底近傍の内周面と接触しており、上端部22uの外周面は有底外管6の底近傍の内周面と接触している。さらに、内管22の上端部22uは、種結晶配置部8の周囲近傍、詳しくは種結晶10と同程度の高さに位置している。また、内管22の内部に、上記原料12が収容されている。なお、内管22は、タンタル、タンタルカーバイド、ニオブカーバイド、モリブデンカーバイドなどの融点が2000℃を超える高融点金属またはその化合物(高融点材料)によって形成してもよい。

【0017】図2は、図1に示す坩堝2を備えた結晶成長装置30を示す断面図である。坩堝2は、水冷式反応管32内で固定されている。坩堝2の外部には、坩堝2の熱が外部へ伝達するのを防止する熱シールド部材34が設けられている。反応管32の周囲には、坩堝2を加熱するための高周波コイル(加熱手段)36が巻回されている。また、反応管32の頂点部には、アルゴンガスなどの不活性ガスを導入できるガス導入管38が介挿され、反応管32の底部には、不活性ガスを外部に排出するためのガス排出管40が介挿されている。

【0018】以上が、本実施形態の坩堝および結晶成長装置の構成である。次に、図1および図2を参照しながら、この坩堝2および結晶成長装置30によって、SiC単結晶を成長させる方法を説明する。

【0019】まず、有底外管4に内管22を挿入した後、当該内管22内にSiC多結晶から成る原料12を収容する。そして、原料12を収容した後、内管22と

有底外管6を嵌合させる。これにより、有底外管4の開口端4oと有底外管6の開口端6oとが密着固定し、図1に示す坩堝2が完成する。次いで、この坩堝2を結晶成長装置30の反応管32内に配置して、図2に示す状態とする。

【0020】結晶成長装置30の準備が完了したら、高周波コイル36によって坩堝2を加熱する。このとき、原料12の温度が約2300~約2500℃となり、種結晶10の温度が約2000~約2400℃となるように温度勾配を設ける。これにより、SiC多結晶からなる原料12が昇華して、当該昇華した原料12のガスが種結晶10に到達し、種結晶10の表面にSiC単結晶が成長する。なお、原料12および種結晶10の温度設定は、抵抗加熱法によって行ってもよい。

【0021】このとき、本実施形態では、有底外管4の 底近傍から有底外管6の底近傍まで延在する内管22が 備えられているため、有底外管4の開口端40と有底外 管6の開口端60との接続部分から原料12または昇華 した原料12のガスが外部に漏れるという事態を防止す ることができる。

【0022】また、原料12を昇華させた際に、有底外管6の内周面のうち内管22で覆われている部分では、SiCの再結晶は起こらない。さらに、内管22の下端部221は原料12に接するため、加熱される原料12の熱が内管22全体に伝達される。このため、内管22の温度低下が防止され、当該内管22の内周面でSiCは再結晶せず、殆どのSiCを種結晶10上で再結晶させることができる。

【0023】なお、内管22の上端部22uの位置は、図1のように種結晶配置部8の近傍に限定されるわけで 30はなく、種結晶10より下方に位置しても良い。但し、有底外管6の内周面におけるSiCの再結晶を確実に防止することを考慮すると、上端部22uの位置は種結晶10と同程度以上の高さにあることが望ましい。

【0024】種結晶10でのSiC単結晶の成長が終了

した後は、有底外管6を有底外管4および内管22から

抜去し、さらに、内管22を有底外管4から抜き出す。これにより、有底外管6内に固定された種結晶10上に成長したSiC単結晶を取り出すことができる。このように、本実施形態の坩堝2は、有底外管4と有底外管6を分離できるため、完成したSiCを取り出す際に坩堝を割る必要がなく、坩堝の再利用を図ることができる。【0025】[第2実施形態]次に、図3を用いて、本発明の第2実施形態について説明する。図3は、本実施形態の坩堝42を示す断面図である。本実施形態の坩堝42を示す断面図である。本実施形態の坩堝42が第1実施形態の坩堝2と異なるのは、内管22の上方に、円形の開口孔40が穿設されたマスク部材44が取り付けられている点である。なお、本実施形態で使用される種結晶10の直径は約3.5cmであり、第1実施形態よりも小径の種結晶を使用している。開口孔4

0の直径は、種結晶10の直径と同程度にされており、マスク部材44の上面と種結晶配置部8とは、約5mmの間隔が設けられている。また、マスク部材44には、開口孔40から下方に広がる傾斜面44aが形成されている。

【0026】このような構成の坩堝42を図2に示す結晶成長装置30に組み込んで高周波加熱を行うと、昇華した原料12のガスが開口孔40を通過して種結晶10に到達し、図4に示すように、種結晶10上にSiC単結晶のバルク46が形成される。このように、マスク部材44に形成された開口孔40は、種結晶10の直径が内管22の内径に対して小さい場合に、昇華した原料ガスを種結晶10に導ける点で特に有用である。また、本実施形態においても、第1実施形態と同様に有底外管4の底近傍から有底外管6の底近傍まで延在する内管22が備えられているため、有底外管4の開口端40と有底外管6の開口端60との接続部分から原料12または昇華した原料12のガスが外部に漏れるという事態を防止することができる。

【0027】また、原料12を昇華させた際に、有底外管6の内周面のうち、内管22およびマスク部材44で覆われている部分では、SiCの再結晶は起こらない。さらに、内管22の下端部221は原料12に接するため、加熱される原料12の熱が内管22全体に伝達される。このため、内管22の温度低下が防止され、当該内管22の内周面でSiCは再結晶せず、殆どのSiCを種結晶10上で再結晶させることができる。

【0028】またさらに、内管22の熱はマスク部材44にも伝達されるため、SiC単結晶のバルク46を、図4に示すように先端部(下部中央)が下方に膨らんだ形状に成長させることができる。これに対し、マスク部材44の温度が所定温度よりも低いときは、SiC単結晶はマスク部材44の傾斜面44a上で成長しやすくなる。このため、バルク46は傾斜面44aに沿って成長し、先端部が凹んだ形状になって長尺のバルクを形成することが困難になる。

【0029】バルク46が完成した後は、図5に示すように、有底外管4と有底外管6の接続および内管22とマスク部材44の接続を切り離す。これにより、種結晶10上に成長したSiC単結晶のバルク46を取り出すことができる。このように、本実施形態の坩堝42にないても、第1実施形態と同様に有底外管4と有底外管6を分離できるため、完成したSiCを取り出す際に坩堝を割る必要がなく、坩堝の再利用を図ることができる。【0030】なお、マスク部材42は、内管22の上でなく内管22の内部に収容させてもよい。また、マスク部材42と内管22は、一体的に形成してもよい。これらのときは、内管からマスク部材への熱伝達率が向上、より長尺のバルク46を生成することができる。

【0031】[第3実施形態]次に、図6を用いて、本

発明の第3実施形態について説明する。図6は、本実施形態の坩堝42を示す断面図である。本実施形態の坩堝42が第2実施形態の坩堝2と異なるのは、内管22の構成である。本実施形態の内管22は、黒鉛からなる外側円筒(外周部)22oと、タンタルからなる内側円筒(内周部)22iとから構成されている。なお、内管22の内周部のタンタルは、厚さ約0.1mm程度の薄膜としてもよい。

【0032】このような構成を採用した場合、上記各実施形態のように内管22を黒鉛のみで形成した場合と異 10 なり、種結晶10上で成長するSiC単結晶に炭素のインクルージョン等による欠陥が発生する事態を防止できる。また、内管22をタンタルのみで形成した場合と比較して、高価なタンタルの使用量が少なくなるためコストを削減できると共に、種結晶10上で成長したSiC単結晶の熱膨張率とタンタルの熱膨張率との差に起因する熱応力に基づく欠陥が当該SiC単結晶に発生する事態を防止することができる。

【0033】実際に、本実施形態の坩堝42によって成長させたSiC単結晶の欠陥量を測定したところ、次のような結果を得ることができた。まず、内管22を黒鉛のみで形成した場合と比較すると、炭素のインクルージョン等による欠陥が約23%減少し、さらに、マイクロパイプ等の結晶欠陥が約47%減少した。また、内管22をタンタルのみで形成した場合と比較して、SiC単結晶の熱膨張率とタンタルの熱膨張率との差に起因する熱応力に基づく結晶欠陥を約10%低減することができた。

【0034】以上、本発明者らによってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実 30 施形態に限定されるものではない。例えば、坩堝および結晶成長装置の用途は、SiC単結晶の成長に限定されるわけではなく、この他、ZnSe等のIII-VI族化合物半導体など、広く気相法による結晶成長にも使用することができる。また、内管の形状は円筒形状に限られず、有底外管の形状に合わせて角筒形状などにしてもよい。

[0035]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、原料を収容する第一の有底外管から種結晶配置部を有する第二の有底外管まで延在する内管が備えられているため、第一の有底外管の開口端と第二の有底外管の開口端との接続部分から原料が漏れるという事態を防止できる。また、原料を昇華させた際に、第二の有底外管の内周面のうち内管で覆われている部分では、原料の再結晶は起こらない。さらに、内管の一端は原料に接するため、昇華させられる際に加熱される原料の熱が内管全体に伝達される。このため、内管の温度低下を防止でき、当該内管の内周面で原料は再結晶せず、殆どの原料を種結晶上で再結晶させることができる。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態の坩堝を示す断面図である。

【図2】図1に示す坩堝が配置された結晶成長装置を示す断面図である。

【図3】第2実施形態の坩堝を示す断面図である。

【図4】第2実施形態の坩堝によりSiC単結晶を成長させた状態を示す図である。

【図5】第2実施形態の坩堝を分離した状態を示す図である。

【図6】第3実施形態の坩堝を示す断面図である。

【図7】従来の坩堝を示す断面図である。

【符号の説明】

2…坩堝、4。…開口端、4…有底外管(第一の有底外管)、6。…開口端、6…有底外管(第二の有底外管)、8…種結晶配置部、10,60…種結晶、12,58…原料、14…側管、16…底部材、18…側管、20…蓋部材、22…内管、22。…外側円筒(外周部)、22i…内側円筒(内周部)、30…結晶成長装置、32…反応管、34…熱シールド部材、36…高周波コイル(加熱手段)、38…ガス導入管、40…ガス排出管、40…開口孔、42…坩堝、44…マスク部材、44a…傾斜面、46…バルク、50…坩堝、52,54…有底円筒、54a…内周面、56…接続部分。

